

SMD – Richtkoppler

Kennzeichen:

- » Kompakte Bauform
- » Automatisch bestückbar
- » Für Reflow- und Dampfphasenlötung
- » Keramik-Grundplatte

Anwendungen:

- » HF-Technik
- » Mobilfunk
- » Satellitentechnik

Daten:

Empfohlene Löttechnik:
Reflow

max. Löttemperatur:
230°C, 5 Sek.

Betriebstemperaturbereich:
-40°C bis + 125°C

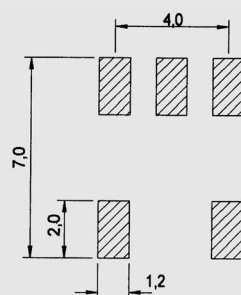
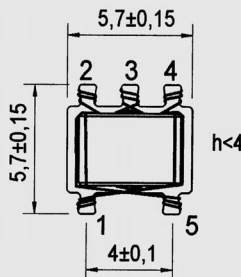
Verpackung siehe Seite 4.60:
Blisterpack IEC 286 / 3

Verpackungseinheit
(Stück / Rolle):
500 / 2000

SM-T6

Abmessungen und Empfehlung für Lötflächenmaße (mm):

Dimensions and recommended pad pattern (mm):



SMD – Directional coupler

Features:

- » Compact design
- » Suitable for automatic insertion
- » For reflow and vapor phase soldering
- » Ceramic base

Applications:

- » RF circuits
- » Mobile radio
- » Satellite TV

Data:

Recommended soldering method:
Reflow

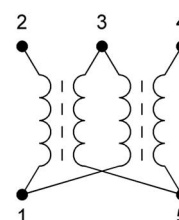
Soldering heat resistance:
230°C, 5 sec.

Operating temperature range:
-40°C to + 125°C

Packaging see page 4.60:
Blisterpack IEC 286 / 3

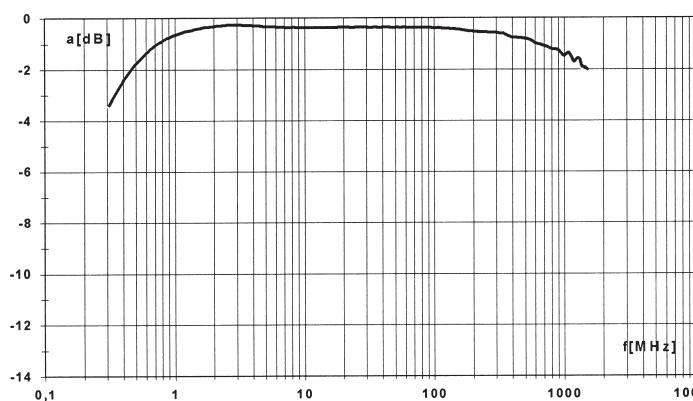
Packaging unit (parts / reel):
500 / 2000

Kopplung Coupling [dB]	3dB Bandbreite 3dB band limits [MHz]	a ₀ [dB]	Art.-Nr. Part number
1 - 8	≤ 0,8 - ≥ 1200	≤ 2,0	00 5533 02
2 - 6	≤ 0,8 - ≥ 1100	≤ 2,8	00 5533 03
10	≤ 0,5 - ≥ 900	≤ 1,2	00 5533 04
16	≤ 0,5 - ≥ 1500	≤ 0,6	00 5533 05



Typische Werte/Typical values:

Durchgangsdämpfung/Directivity:



Typische Werte/Typical values:

Koppeldämpfung/Coupling:

